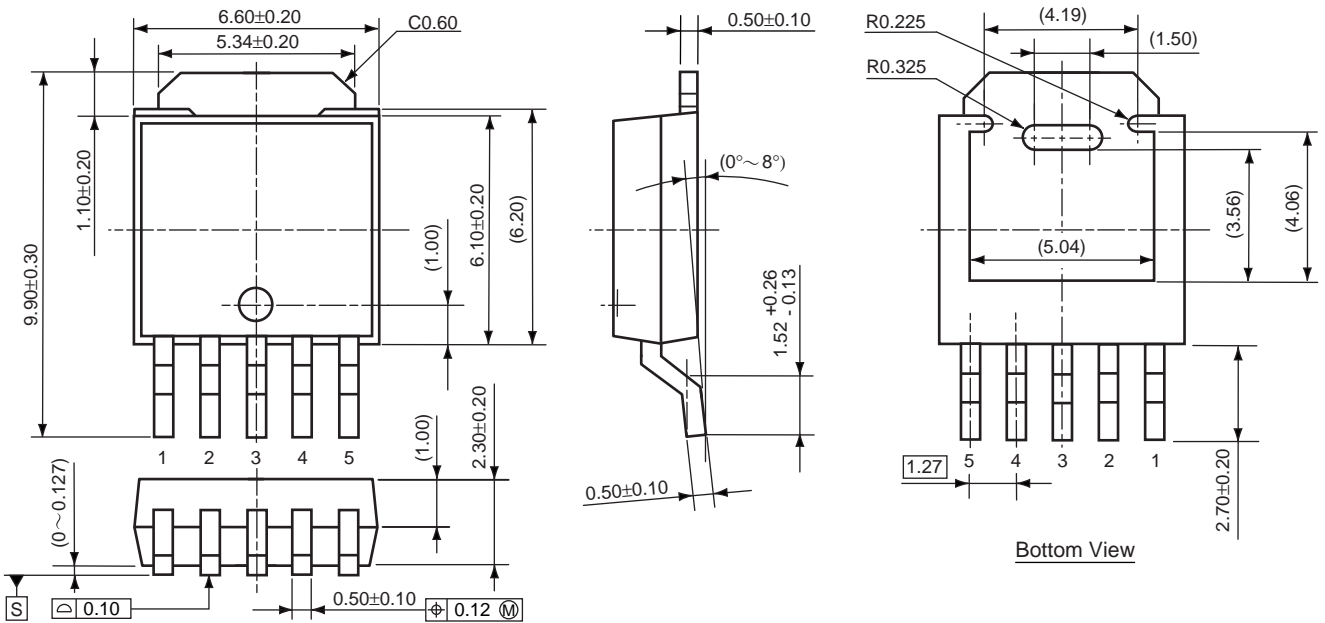


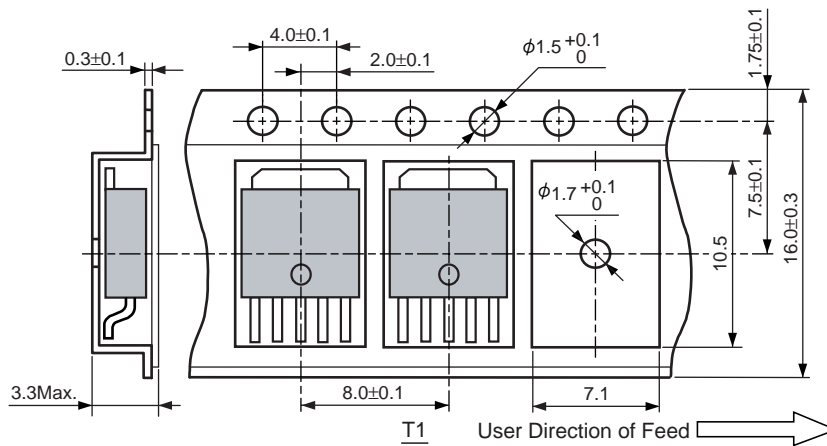
TO-252-5-P2

(単位 : mm)

■ パッケージ外形図

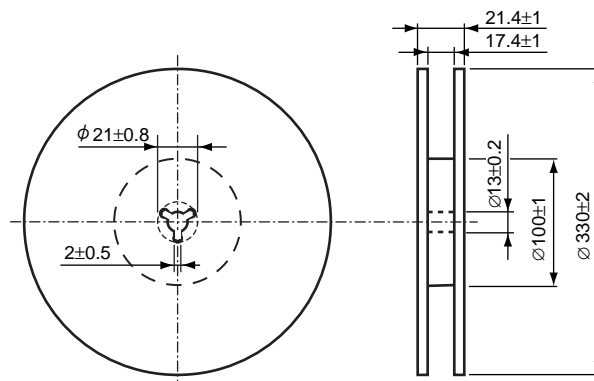


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リユースリール (EIAJ-RRM-16Dc)

(1 リール=3,000 個)



■ 許容損失について (TO-252-5-P2)

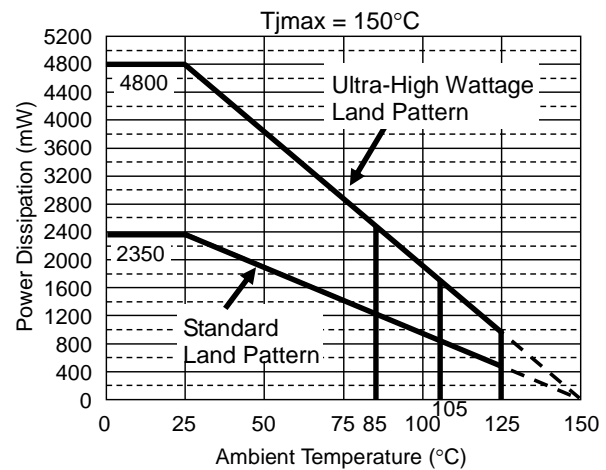
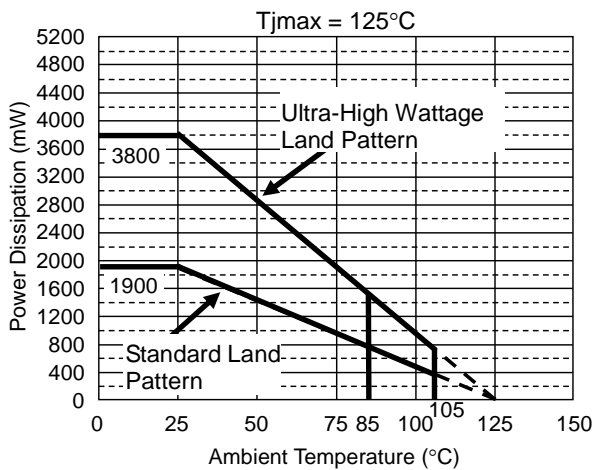
TO-252-5-P2パッケージの許容損失について特性例を示します。
 なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

	標準実装条件	超ハイワットテージ実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	50 mm × 50 mm × 1.6 mm	76.2 mm × 114.3 mm × 0.8 mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%	表裏層 50 mm 角 : 配線率 約 96% 内層 50 mm 角 : 配線率 100%
スルーホール	直径 0.5 mm × 24 個	直径 0.4 mm × 30 個

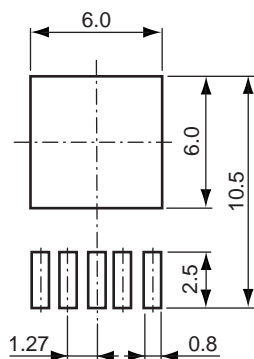
測定結果 (Ta = 25°C)

	標準実装条件	超ハイワットテージ実装条件
許容損失	1900 mW (Tjmax = 125°C) 2350 mW (Tjmax = 150°C)	3800 mW (Tjmax = 125°C) 4800 mW (Tjmax = 150°C)
熱抵抗値	$\theta_{ja} = 53^\circ\text{C/W}$ $\theta_{jc} = 17^\circ\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 26^\circ\text{C/W}$ $\theta_{jc} = 7^\circ\text{C/W}$

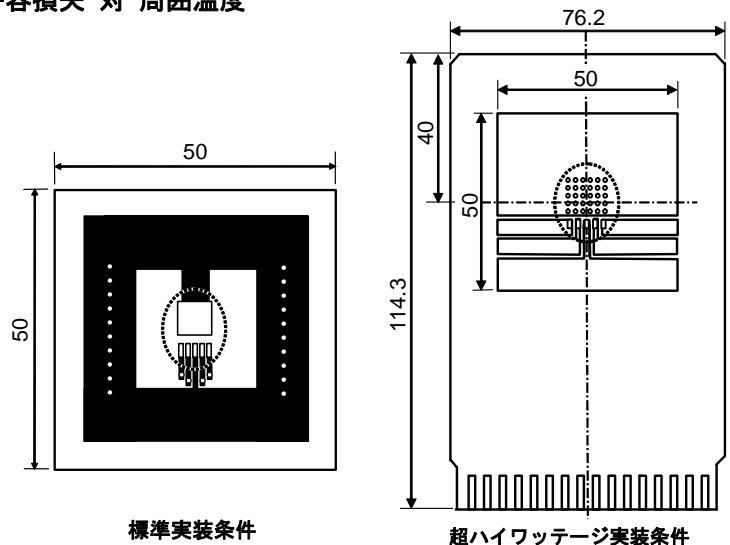


許容損失 対 周囲温度

■ 基板パッド推奨寸法



(単位 :mm)



標準実装条件

超ハイワットテージ実装条件

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

測定用基板レイアウト